

性能特点：

- 频带：1~18GHz
- 插入损耗：0.6dB@18GHz
- 均衡量：6dB
- 输入/输出：50 ohm 匹配
- 芯片尺寸：0.95×1×0.1mm³

产品简介：

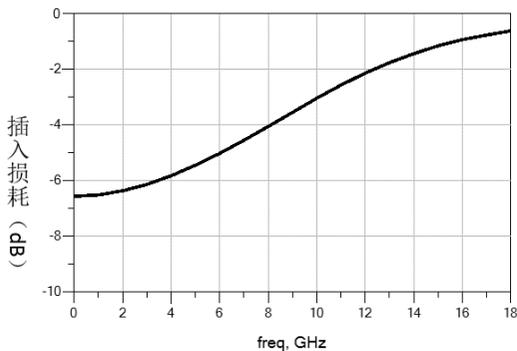
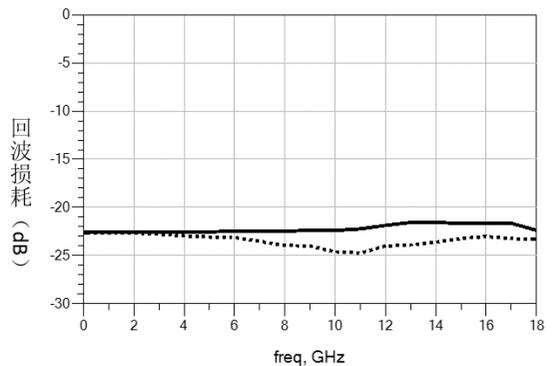
HH-AE0118-6 是一款 GaAs MMIC 均衡器芯片，广泛应用于改善带内波动，均衡器幅度特性，该芯片通过背面金属通孔接地，输入输出考虑金丝键合影响，推荐用 2 根直径 25um 金丝键合，键合线长度 300um 左右最佳。。

电参数：(T_A=25°C)

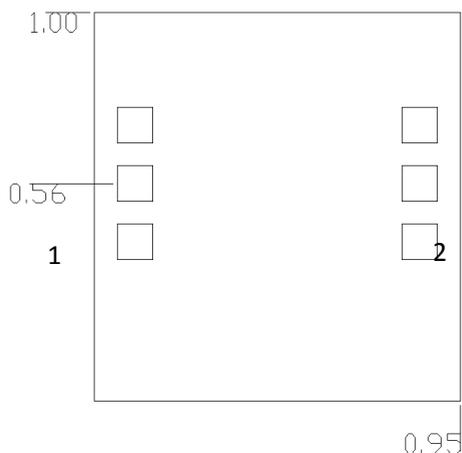
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	1~18			GHz
插入损耗@18GHz	-	0.6	-	dB
均衡量	-	6	-	dB
回波损耗	-	22	-	dB

使用限制参数：

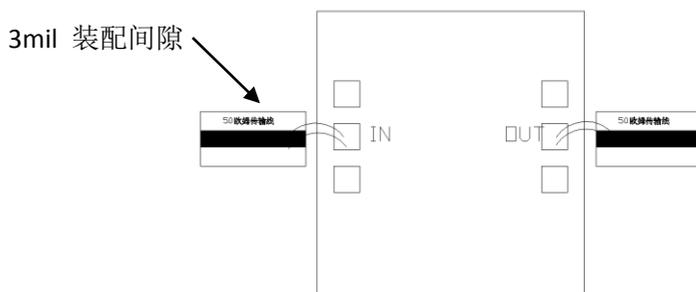
输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C~175°C
使用温度	-55°C~85°C

典型曲线：
插入损耗

回波损耗


尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



焊盘序号	功能	描述
1,2	RF1, RF2	该系列焊盘射频支路端

使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）